

2009-2012年中国半导体材料产业市场运行动态及投资前景咨询报告



一、调研说明

《2009-2012年中国半导体材料产业市场运行动态及投资前景咨询报告》是艾凯咨询集团经过数月的周密调研,结合国家统计局,行业协会,工商,税务海关等相关数据,由行业内知名专家撰写而成。报告意于成为从事本行业人士经营及投资提供参考的重要依据。

报告主要可分为四大部分,首先,报告对本行业的特征及国内外市场环境进行描述;其次,是本行业的上下游产业链,市场供需状况及竞争格局从宏观到细致的详尽剖析,接着报告中列出数家该行业的重点企业,分析相关经营数据;最后,对该行业未来的发展前景,投资风险给出指导建议。相信该份报告对您把握市场脉搏,知悉竞争对手,进行战略投资具有重要帮助。

官方网址: https://www.icandata.com/view/115617.html

报告价格: 纸介版9000元 电子版9000元 纸介版+电子版9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: sales@icandata.com

联系人: 刘老师

特别说明:本PDF目录为计算机程序生成,格式美观性可能有欠缺;实际报告排版规则、美观。

二、摘要、目录、图表

- 第一章 2008-2009年全球半导体行业运行态势分析
- 第一节 2008-2009年全球半导体产业发展分析
- 一、全球半导体产业发生巨变
- 二、世界半导体产业进入整合期
- 三、全球半导体产业新进展
- 四、国际半导体市场增长减缓
- 第二节 2008-2009年中国半导体产业分析
- 一、中国半导体产业简要分析
- 二、中国半导体产业局势良好
- 三、2008年中国半导体产业遭遇拐点
- 四、两化融合促进半导体行业发展
- 第三节 2008-2009年中国半导体市场的发展概况
- 一、2008年中国半导体市场分析
- 二、中国半导体市场增速放慢
- 三、2008年中国半导体市场销售收入再次增长
- 四、中国半导体企业市场占有率偏低
- 第四节 2008-2009年中国半导体发展存在的问题
- 一、中国半导体产业发展面临的瓶颈
- 二、核心技术缺失阻碍中国半导体产业发展
- 三、中国半导体产业材料和设备严重滞后
- 四、中国半导体产业面临的挑战
- 第五节 2008-2009年中国半导体发展的策略分析
- 一、中国半导体产业应主动参与海外收购
- 二、应尽快同步发展半导体支撑材料配套业
- 三、中国半导体产业追求创新与创收双赢
- 第二章 2008-2009年全球半导体材料产业运行状况分析
- 第一节 2008-2009年国际半导体材料发展综述
- 一、世界半导体材料产业快速发展
- 二、世界半导体材料市场强劲增长
- 三、半导体材料市场再创新高

第二节 2008-2009年全球半导体材料产业市场动态分析

- 一、世界半导体封装材料规模
- 二、世界半导体硅材料发展现状
- 三、半导体材料的过去、现在和将来

第三节 2009-2012年世界半导体材料产业规模预测分析

第三章 2008-2009年全球半导体材料主要地区运行透析

第一节 美国半导体材料

- 一、美国开发出新型半导体材料
- 二、美国开发出的新材料可降低成本
- 三、美国利用钴绿开发新半导体材料
- 四、美国道康宁推出半导体材料发展新模式
- 第二节 日本半导体材料
- 一、日本开发出微磁性半导体材料
- 二、日本开发出钻石半导体材料
- 三、日本有机半导体材料电子迁移率高
- 四、日本半导体材料巨头加大投资以增产

第三节 中国台湾半导体材料的发展状况分析

- 一、台湾跃登全球半导体材料第二大市场
- 二、台湾硅晶圆市场快速成长
- 三、台湾成为最大半导体设备投资市场
- 四、台湾建成半导体材料实验室

第四章 2008-2009年中国半导体材料产业运行环境分析

第一节 2008-2009年中国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP分析
- 二、城乡居民家庭人均可支配收入与恩格尔系数
- 三、工业发展形势分析

第二节 2008-2009年中国半导体材料产业政策环境分析

- 一、产业政策解读
- 二、相关产业政策影响分析
- 三、进出口政策分析

第三节 2008-2009年中国半导体材料产业社会环境分析

第五章 2008-2009年中国半导体材料产业运行形势分析

第一节 2008-2009年中国半导体材料行业发展综述

- 一、中国是最受关注的半导体材料市场
- 二、半导体材料的发展状况分析
- 三、半导体材料市场需求巨大
- 四、国产半导体材料新品不断

第二节 2008-2009年中国半导体材料的研究应用状况

- 一、半导体材料的研究主题
- 二、中国半导体材料的研究进展
- 三、半导体材料的应用分析
- 四、绿色半导体材料应用干高温汽车

第三节 2008-2009年中国半导体材料发展中存在的问题及建议

- 一、新材料产生的污染问题
- 二、中国半导体材料业应开拓创新
- 三、发展中国半导体材料的几点建议

第六章 2008-2009年中国半导体硅材料产业运行动态分析

第一节 2008-2009年中国硅材料业的发展分析

- 一、半导体硅材料产业迅猛发展
- 二、乐山市硅材料产业迅速崛起
- 三、中国半导体硅材料行业发展的新特点

第二节 2008-2009年中国半导体硅材料发展中的问题

- 一、技术落后阻碍半导体硅材料发展
- 二、六大问题制约高纯硅材料产业发展
- 三、多晶硅价格居高不下给国内企业带来压力

第三节 2008-2009年中国半导体硅材料的发展对策

- 一、加快半导体硅材料行业发展的建议
- 二、发展硅材料行业的策略
- 三、国内硅材料企业的竞争策略

第七章 2008-2009年中国半导体材料氮化镓产业运行走势分析

- 第一节 第三代半导体材料相关介绍
- 一、第三代半导体材料的发展历程
- 二、第三代半导体材料得到推广
- 三、宽禁带半导体材料
- 第二节2008-2009年中国氮化镓的发展概况
- 一、氮化镓半导体材料市场的发展状况
- 二、氮化镓照亮半导体照明产业
- 三、GaN蓝光产业的重要影响

第三节2008-2009年中国氮化镓的研发和应用状况

- 一、中科院研制成功氮化镓基激光器
- 二、方大集团率先实现氮化镓基半导体材料产业化
- 三、非极性氮化镓材料的研究有进展
- 四、氮化镓的应用范围
- 五、氮化镓晶体管的应用分析

第八章 2008-2009年中国其他半导体材料产业市场局势分析

- 第一节 砷化镓
- 一、砷化镓单晶材料的发展
- 二、砷化镓的特性
- 三、砷化镓产业的发展应用状况
- 四、中国最大的砷化镓材料生产基地投产
- 第二节 碳化硅
- 一、半导体材料碳化硅介绍
- 二、碳化硅材料的特性
- 三、高温碳化硅制造装置的组成
- 四、中国碳化硅的研发与产业化项目取得重大突破

第九章 2008-2009年中国半导体材料产业市场竞争格局分析

第一节 2008-2009年中国半导体材料产业竞争现状分析

- 一、半导体材料竞争力分析
- 二、世界两大半导体材料厂商投资竞争

- 三、半导体材料竞争无线应用领域
- 第二节 2008-2009年中国半导体材料产业区域格局分析
- 一、重点生产企业集中分布
- 二、市场消费区域竞争力分析
- 三、重点省市对比分析

第三节 2008-2009年中国半导体材料产业提升竞争力策略分析

- 第十章 2008-2009年中国国外半导体材料优势企业经营状况解析
- 第一节 信越化学工业株式会社
- 一、公司简介
- 二、2008-2009财年信越化学工业株式会社经营状况
- 三、公司竞争力分析
- 第二节 WACKER CHEMIE
- 一、公司简介
- 二、2007-2009年Wacker公司经营状况
- 三、公司竞争力分析
- 第三节 三菱住友株式会社(SUMCO)
- 一、公司简介
- 二、2008-2009财年三菱住友经营状况分析
- 三、公司竞争力分析
- 第十一章 2008-2009年中国半导体材料重点企业竞争力分析
- 第一节 有研半导体材料股份有限公司
- 一、公司概况
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司盈利能力及偿债能力分析
- 四、公司成长能力
- 五、公司经营效率
- 六、公司竞争力分析
- 第二节 天津中环半导体股份有限公司
- 一、公司概况
- 二、公司主要财务指标分析

- 三、公司盈利能力及偿债能力分析
- 四、公司成长能力
- 五、公司经营效率
- 六、公司竞争力分析

第三节 浙江海纳科技股份有限公司

- 一、公司概况
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司盈利能力及偿债能力分析
- 四、公司成长能力
- 五、公司经营效率
- 六、公司竞争力分析

第四节 峨眉半导体材料厂

- 一、公司简介
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司成本费用情况
- 四、公司未来战略分析

第五节 洛阳中硅高科有限公司

- 一、公司简介
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司成本费用情况
- 四、公司未来战略分析

第六节 北京国晶辉红外光学科技有限公司

- 一、公司简介
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司成本费用情况
- 四、公司未来战略分析

第七节 北京中科镓英半导体有限公司

- 一、公司简介
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司成本费用情况
- 四、公司未来战略分析

第八节 上海九晶电子材料有限公司

- 一、公司简介
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司成本费用情况
- 四、公司未来战略分析

第九节 东莞钛升半导体材料有限公司

- 一、公司简介
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司成本费用情况
- 四、公司未来战略分析

第十节 河南新乡华丹电子有限责任公司

- 一、公司简介
- 二、公司主要财务指标分析
- 三、公司成本费用情况
- 四、公司未来战略分析

第十一节略。。。。。。。。。。

第十二章 2008-2009年中国半导体材料相关行业分析

- 第一节 半导体分立器件
- 一、半导体分立器件市场稳健发展
- 二、2007-2008年全国及主要省份半导体分立器件产量分析
- 三、2008年国内半导体分立器件的发展热点
- 四、中国半导体分立器件进出口分析
- 五、以新思维发展半导体分立器件产业
- 六、半导体分立器件未来的三大发展特点
- 第二节 半导体集成电器
- 一、集成电路产业的发展状况
- 二、中国各地区半导体集成电路发展概况
- 三、2007-2008年全国及重点省份半导体集成电路产量分析
- 四、半导体集成电路发展需创新
- 五、集成电路产业的错位竞争策略
- 六、2011年中国集成电路产业规模将突破1万亿元

第三节 LED产业

- 一、LED在中国的发展
- 二、中国LED产业形成新格局
- 三、中国LED市场混乱
- 四、半导体照明LED产业前途光明
- 五、2010年中国LED产业产值预测
- 第十三章 2009-2012年中国半导体材料的发展趋势预测分析
- 第一节 2009-2012年中国半导体产业的前景分析
- 一、中国半导体产业前景光明
- 二、2010年中国大陆将占世界半导体市场1/3
- 三、半导体设备业前景分析
- 四、半导体技术发展的低耗能趋势
- 第二节 2009-2012年中国半导体材料产业发展趋势分析
- 一、半导体材料的发展趋势
- 二、2010年化合物半导体材料市场预测
- 三、半导体清模材料的发展趋势
- 四、利用半导体材料开发新能源的前景
- 第三节 2009-2012年中国半导体材料产业市场预测分析
- 第十四章 2009-2012年中国半导体材料产业投资机会与风险分析
- 第一节 2009-2012年中国半导体材料产业投资环境分析
- 一、宏观经济预测分析
- 二、金融危机影响分析
- 第二节 2009-2012年中国半导体材料产业投资机会分析
- 第三节 2009-2012年中国半导体材料产业投资风险分析
- 一、市场运营风险
- 二、技术风险
- 三、政策风险
- 四、原材料风险
- 五、进入退出风险
- 第四节 专家投资建议

图表名称:部分

图表 2004-2008年有研半导体材料股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表 2004-2008年有研半导体材料股份有限公司净利润增长趋势图

图表 2004-2008年有研半导体材料股份有限公司利润率走势图

图表 2004-2008年有研半导体材料股份有限公司盈利能力指标表

图表 2004-2008年有研半导体材料股份有限公司偿债能力指标表

图表 2004-2008年有研半导体材料股份有限公司成长能力指标表

图表 2004-2008年有研半导体材料股份有限公司经营能力指标表

图表 2004-2008年天津中环半导体股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表 2004-2008年天津中环半导体股份有限公司净利润增长趋势图

图表 2004-2008年天津中环半导体股份有限公司利润率走势图

图表 2004-2008年天津中环半导体股份有限公司盈利能力指标表

图表 2004-2008年天津中环半导体股份有限公司偿债能力指标表

图表 2004-2008年天津中环半导体股份有限公司成长能力指标表

图表 2004-2008年天津中环半导体股份有限公司经营能力指标表

图表 2004-2008年浙江海纳科技股份有限公司主营业务收入增长趋势图

图表 2004-2008年浙江海纳科技股份有限公司净利润增长趋势图

图表 2004-2008年浙江海纳科技股份有限公司利润率走势图

图表 2004-2008年浙江海纳科技股份有限公司盈利能力指标表

图表 2004-2008年浙江海纳科技股份有限公司偿债能力指标表

图表 2004-2008年浙江海纳科技股份有限公司成长能力指标表

图表 2004-2008年浙江海纳科技股份有限公司经营能力指标表

图表 峨眉半导体材料厂盈利指标情况

图表 峨眉半导体材料厂资产运行指标状况

图表 峨眉半导体材料厂资产负债能力指标分析

图表 峨眉半导体材料厂盈利能力情况

图表 峨眉半导体材料厂销售收入情况

图表 峨眉半导体材料厂成本费用构成情况

图表 洛阳中硅高科有限公司盈利指标情况

图表 洛阳中硅高科有限公司资产运行指标状况

图表 洛阳中硅高科有限公司资产负债能力指标分析

图表 洛阳中硅高科有限公司盈利能力情况

图表 洛阳中硅高科有限公司销售收入情况

图表 洛阳中硅高科有限公司成本费用构成情况

图表 北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利指标情况

图表 北京国晶辉红外光学科技有限公司资产运行指标状况

图表 北京国晶辉红外光学科技有限公司资产负债能力指标分析

图表 北京国晶辉红外光学科技有限公司盈利能力情况

图表 北京国晶辉红外光学科技有限公司销售收入情况

图表 北京国晶辉红外光学科技有限公司成本费用构成情况

图表 北京中科镓英半导体有限公司盈利指标情况

图表 北京中科镓英半导体有限公司资产运行指标状况

图表 北京中科镓英半导体有限公司资产负债能力指标分析

图表 北京中科镓英半导体有限公司盈利能力情况

图表 北京中科镓英半导体有限公司销售收入情况

图表 北京中科镓英半导体有限公司成本费用构成情况

图表 上海九晶电子材料有限公司盈利指标情况

图表 上海九晶电子材料有限公司资产运行指标状况

图表 上海九晶电子材料有限公司资产负债能力指标分析

图表 上海九晶电子材料有限公司盈利能力情况

图表 上海九晶电子材料有限公司销售收入情况

图表 上海九晶电子材料有限公司成本费用构成情况

图表 东莞钛升半导体材料有限公司盈利指标情况

图表 东莞钛升半导体材料有限公司资产运行指标状况

图表 东莞钛升半导体材料有限公司资产负债能力指标分析

图表 东莞钛升半导体材料有限公司盈利能力情况

图表 东莞钛升半导体材料有限公司销售收入情况

图表 东莞钛升半导体材料有限公司成本费用构成情况

图表 河南新乡华丹电子有限责任公司盈利指标情况

图表 河南新乡华丹电子有限责任公司资产运行指标状况

图表 河南新乡华丹电子有限责任公司资产负债能力指标分析

图表 河南新乡华丹电子有限责任公司盈利能力情况

图表 河南新乡华丹电子有限责任公司销售收入情况

图表 河南新乡华丹电子有限责任公司成本费用构成情况

图表 2009-2012年中国半导体产业的前景分析 图表 2009-2012年中国半导体材料产业市场预测分析 图表 略。。。。。。。。。。。。。

详细请访问: https://www.icandata.com/view/115617.html

三、研究方法

- 1、系统分析方法
- 2、比较分析方法
- 3、具体与抽象方法
- 4、分析与综合方法
- 5、归纳与演绎方法
- 6、定性分析与定量分析方法
- 7、预测研究方法

四、数据来源

对行业内相关的专家、厂商、渠道商、业务(销售)人员及客户进行访谈,获取最新的 一手市场资料;

艾凯咨询集团长期监测采集的数据资料;

行业协会、国家统计局、海关总署、国家发改委、工商总局等政府部门和官方机构的数据与资料;

行业公开信息;

行业企业及上、下游企业的季报、年报和其它公开信息;

各类中英文期刊数据库、图书馆、科研院所、高等院校的文献资料;

行业资深专家公开发表的观点;

对行业的重要数据指标进行连续性对比,反映行业发展趋势;

中华人民共和国国家统计局 http://www.stats.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局 http://www.saic.gov.cn

中华人民共和国海关总署 http://www.customs.gov.cn

中华人民共和国商务部 http://www.mofcom.gov.cn

中国证券监督管理委员会 http://www.csrc.gov.cn

中华人民共和国商务部 http://www.mofcom.gov.cn

世界贸易组织 https://www.wto.org

联合国统计司 http://unstats.un.org

联合国商品贸易统计数据库 http://comtrade.un.org

五、关于艾凯咨询网

艾凯咨询网(www.icandata.com)隶属艾凯咨询集团(北京华经艾凯企业咨询有限公司) ,艾凯咨询集团专注提供大中华区产业经济情报,为企业商业决策赋能,是领先的市场研究 报告和竞争情报提供商

艾凯咨询集团为企业提供专业投资咨询报告、深度研究报告、市场调查、统计数据等。 艾凯咨询网每天更新大量行业分析报告、图表资料、竞争情报、投资情报等,为用户及时了 解迅速变化中的世界和中国市场提供便利,为企业商业决策赋能。

研究力量

高素质的专业的研究分析团队,密切关注市场最新动向。在多个行业,拥有数名经验丰富的专业分析师。对于特定及专属领域,我们有国内外众多合作研究机构,同时我们聘请数名行业资深专家顾问,帮助客户分清市场现状和趋势,找准市场定位和切入机会,提出合适中肯的建议,帮助客户实现价值,与客户一同成长。

我们的优势

权威机构 艾凯咨询集团二十年深厚行业背景:

数量领先囊括主流研究报告和权威合作伙伴:

服务齐全 促销、推荐指数、积分、网上支付等;

良好声誉广泛知名度、满意度,众多新老客户。